陈明祥教授课题组诚聘博士后

陈明祥，华中科技大学机械学院教授、博士生导师、广东省珠江学者讲座教授。课题组长期从事电子封装技术与新材料研究，包括功率电子器件封装（LED/LD/IGBT/CPV）、低温键合、纳米封装技术等，团队研究氛围良好。近期承担了总装预研重点基金、国家重点研发计划、国家自然科学基金、湖北省和武汉市科技攻关等10多项研发课题（研究内容涉及高温电子封装、第三代半导体封装技术等）。研发成果曾获国家技术发明二等奖、教育部技术发明一等奖、广东省科技二等奖等。课题组关注产业关键技术研发与产学研合作，其中电镀陶瓷基板（DPC）技术已实现产业化。

陈明祥教授简介：<http://mse.hust.edu.cn/info/1011/11767.htm>

**一、应聘条件**

1）全职脱产博士后，年龄在30岁以下，博士毕业不超过3年；

2）招生专业与方向：材料学、电子封装、半导体等；

3）在国外专业期刊上发表过学术论文，有相关科研项目经验者优先；

4）富有科研探索和团队合作精神，主动性强、执行力强、表达能力强（写作和英语）。

**二、工作条件及待遇**

1）年薪20W+，同时享受学校、学院和课题组规定的其他待遇；

2）课题组提供良好的科研环境与实验条件，鼓励结合课题组研发基础创立新的研究方向，申报国家基金、博士后基金等研究课题；

3）近期合作方向：功率器件（含第三代半导体）封装、纳米封装技术等；

4）子女入托、中小学入学等享受校内职工同等待遇。

**三、申请材料**

1）个人详细简历（包括个人基本信息、学习经历、参与科研项目等）；

2）代表性研究成果（博士论文、已发表论文或专利申请等）；

3）应聘后研究工作设想、计划和要求。

**四、申请方式**

申请材料请发送到邮箱：chimish@hust.edu.cn，并注明“应聘博士后+姓名”。

**五、其他**

1）根据科研和项目需求，每年招聘1-2人；

2）本招聘信息长年有效。